

2009年3月期(08年度) 決算説明会

2009年5月18日

株式会社 東京精密

代表取締役社長 藤森 一雄

代表取締役CFO 太田 邦正

将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料及び当社代表者が口頭にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従いまして、実際の今後の当社の業績が、本プレゼンテーションにおける記述、情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



(株)東京精密 2009年3月期(08年度) 決算説明会

次第

16:30

開会

16:30 – 16:45 2008年度業績説明

代表取締役CFO

太田 邦正

16:45 – 17:00 市場環境・2009年度業績予想
当社の戦略

代表取締役社長

藤森 一雄

08年度 業績

単位: 億円

	07年度 実績	08年度 実績	前年比 (%)	08年度 2月予想	予想対比 (億円)
売上高	918	457	△50.2%	455	2
半導体	675	247	△63.3%	242	5
計測	243	210	△13.8%	213	△3
営業利益	104.5	△24.7	—	△25.0	0.3
半導体	44.5	△59.3	—	-	-
同率	6.6%	—	—	-	-
計測	60.0	34.6	△42.2%	-	-
同率	24.6%	16.5%	—	-	-
経常利益	93.8	△28.4	—	△30.0	1.6
当期利益	48.1	△112.0	—	△120.0	8.0



08年度セグメント別四半期実績

単位: 億円

	07年度	08年度					YoY
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	225	149	169	78	61	△73%	
半導体	157	91	101	32	23	△86%	
計測	68	58	68	46	38	△44%	
営業利益	26	12	9	△11	△35	-	
半導体	8	△1	△5	△17	△36	-	
同率	5%	-	-	-	-	-	
計測	18	13	14	6	1	△92%	
同率	26%	22%	21%	14%	4%	-	
経常利益	16	17	8	△20	△33	-	
当期利益	6	△6	4	△87	△23	-	

構造改革の実施

◆ 外観検査装置事業： 特損46億円

- 新規開発取止め
- 既存機サポート継続

◆ 米国事業の再構築： 特損25億円

- デバイスエッジ開発凍結
- 米国現地法人清算

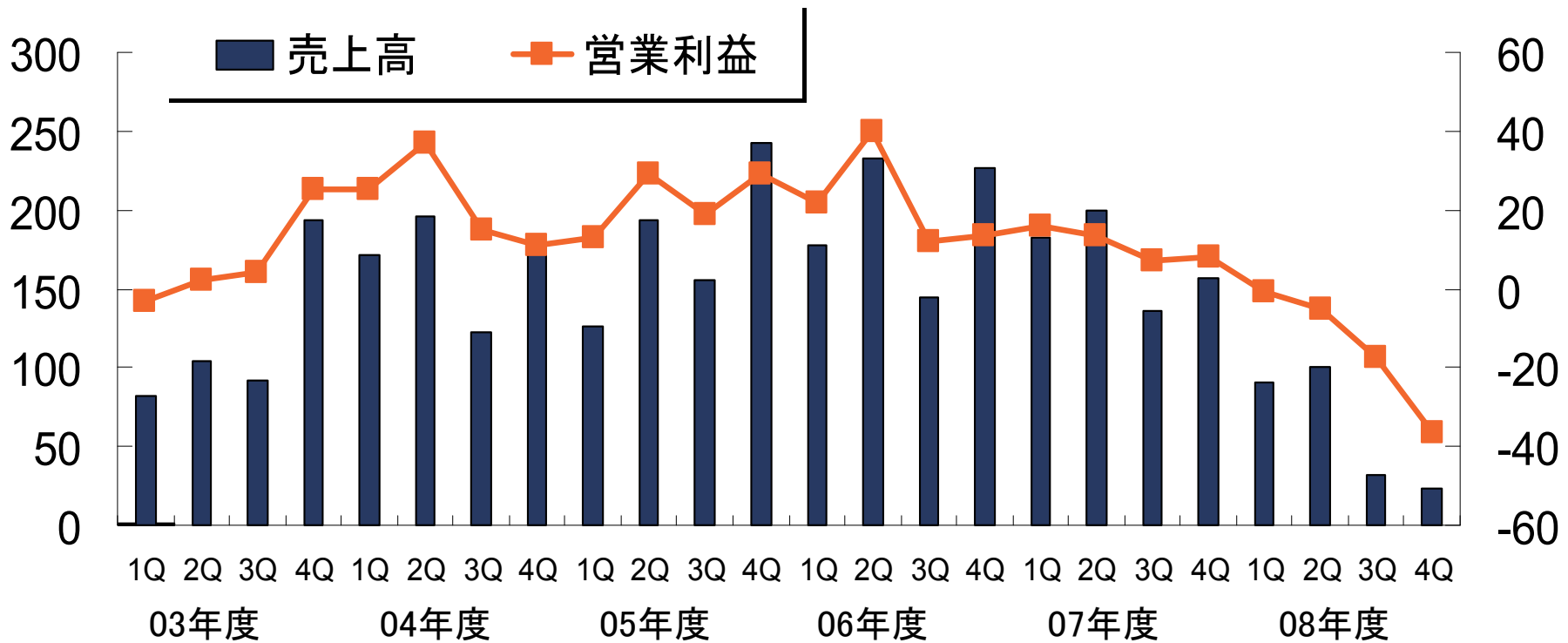
◆ その他の特別損失

- 棚卸資産経過分期首評価損(25億)、希望退職特別割増金(8億) 等

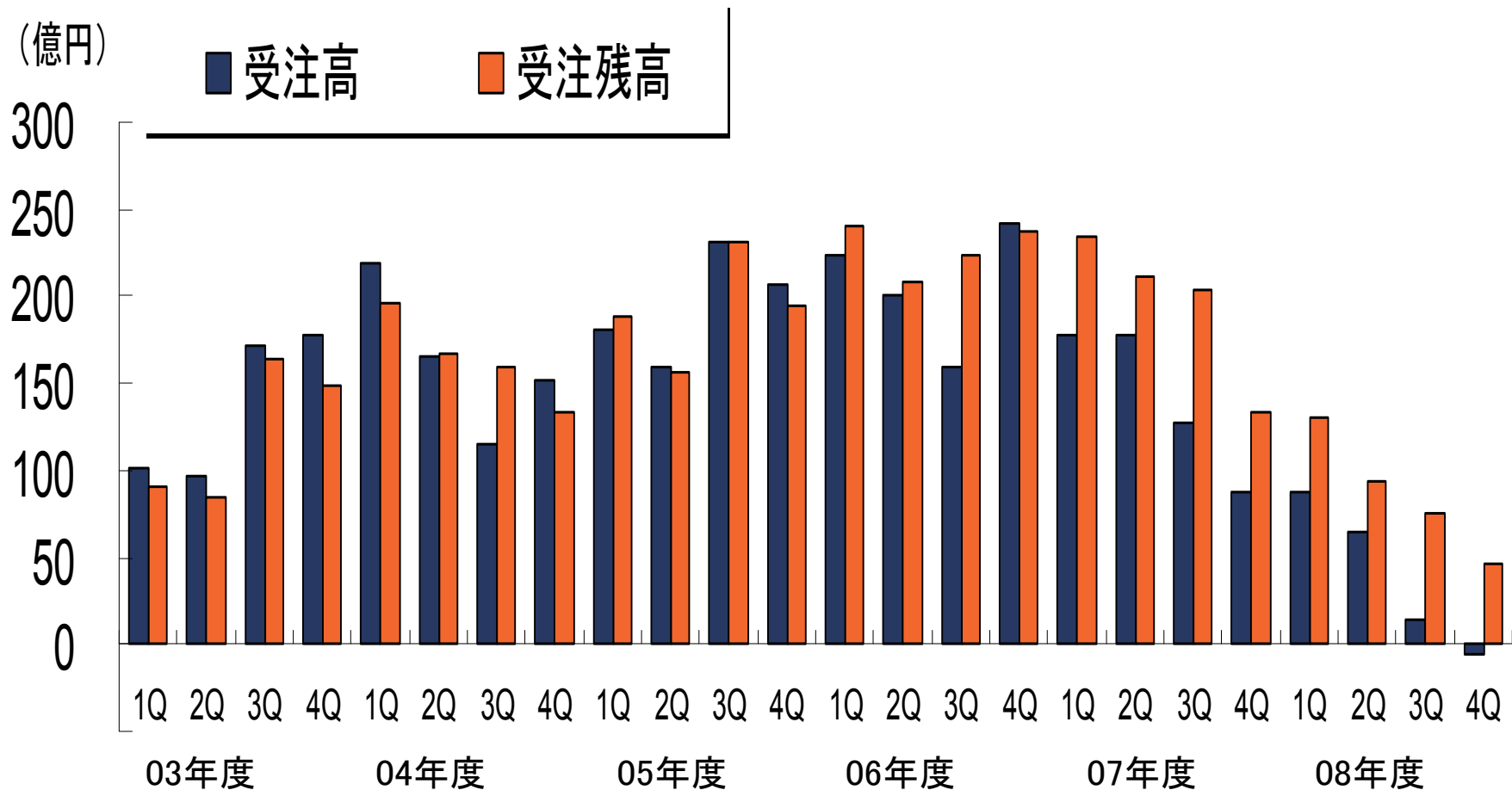
半導体事業の業績推移

売上高
(億円)

営業利益
(億円)

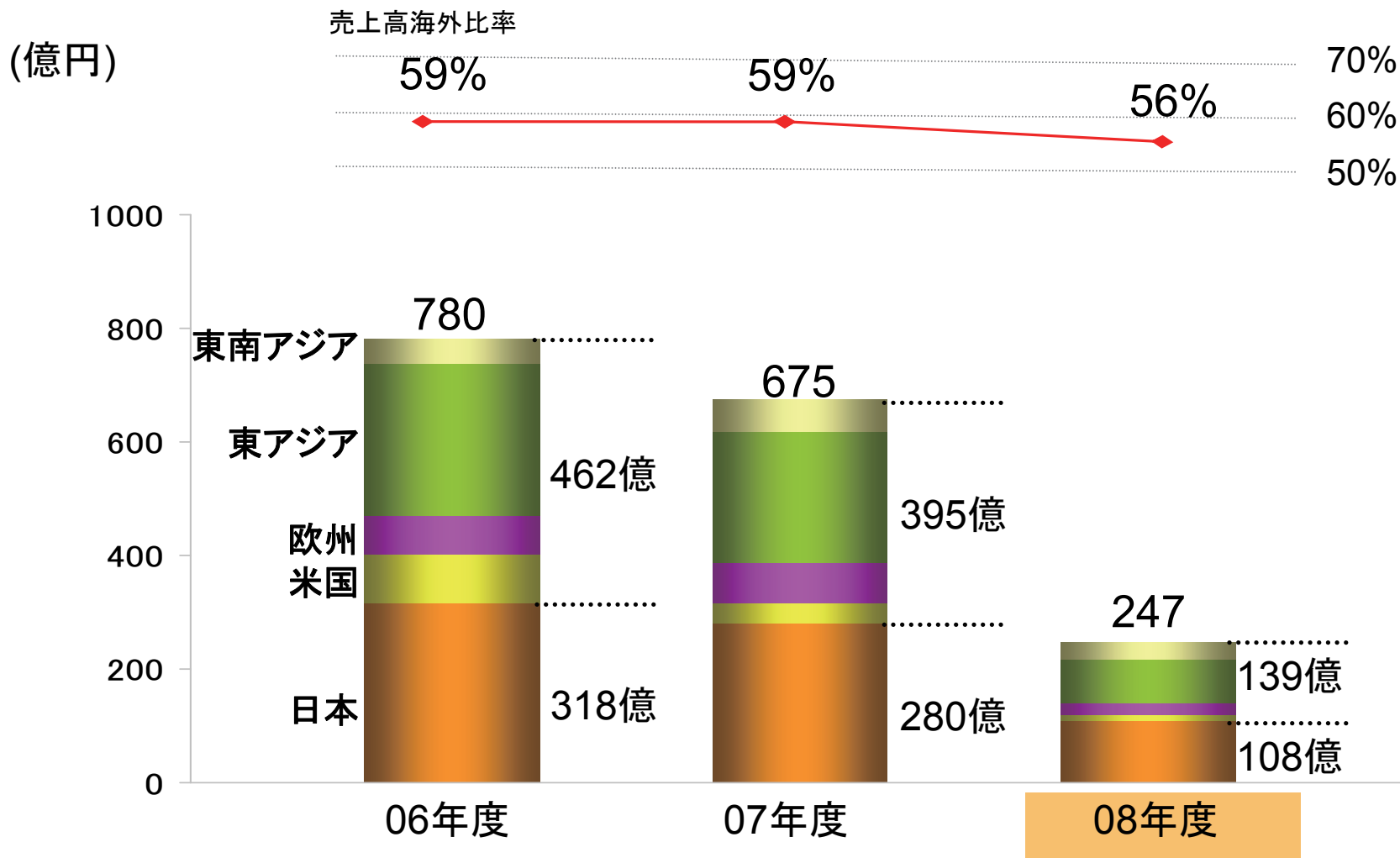


半導体事業の受注推移

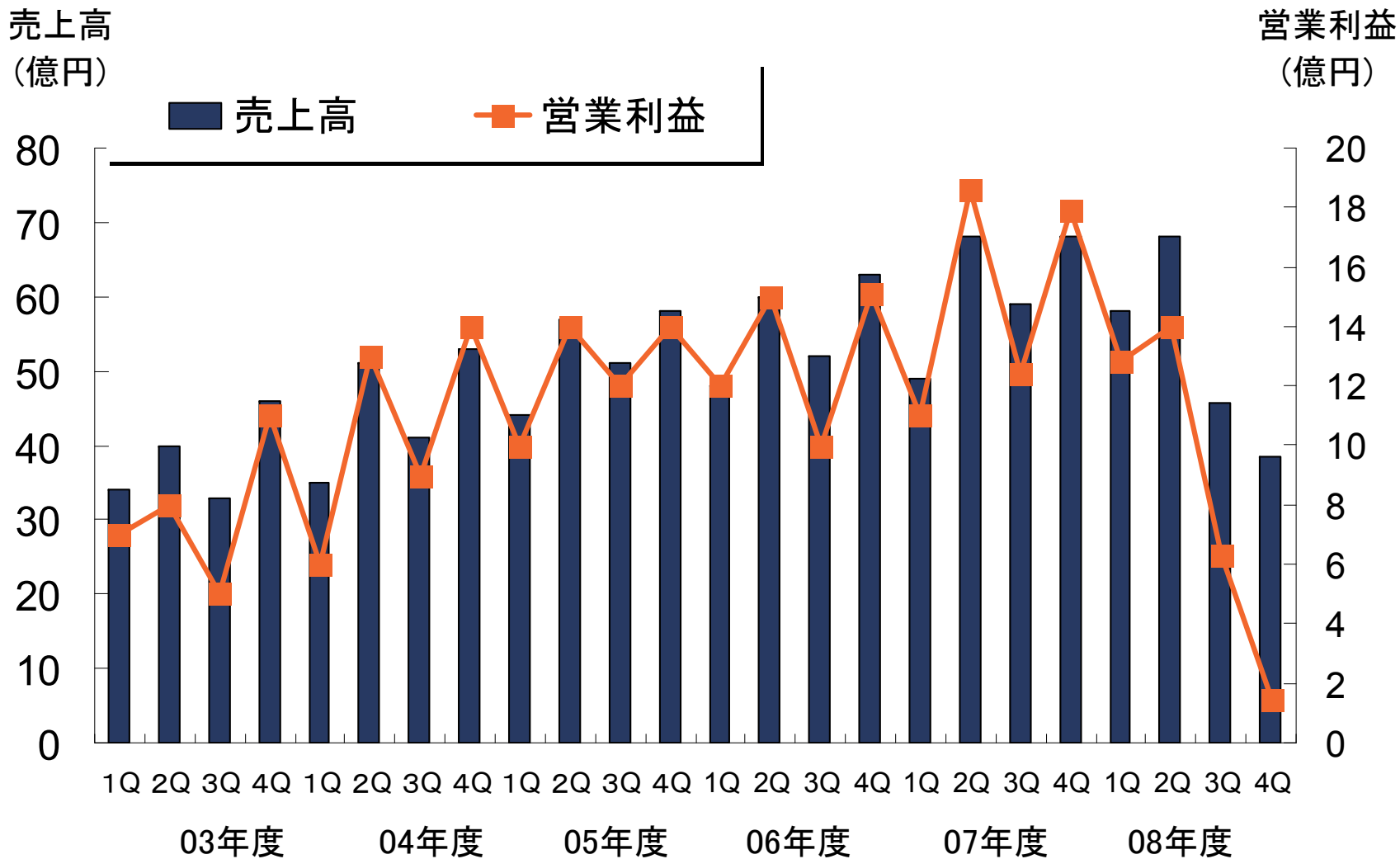




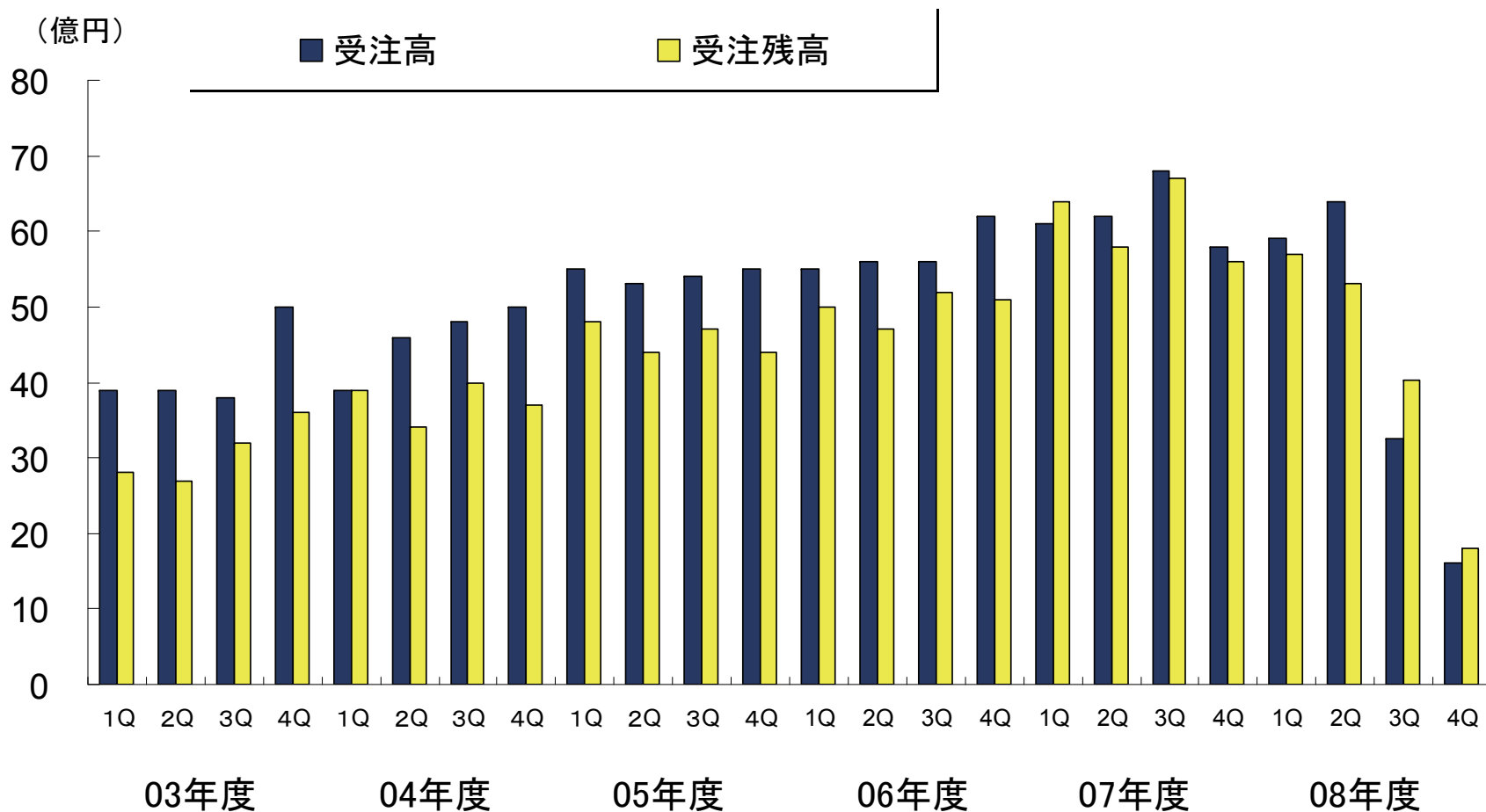
半導体事業の地域別売上高推移



計測事業の業績推移

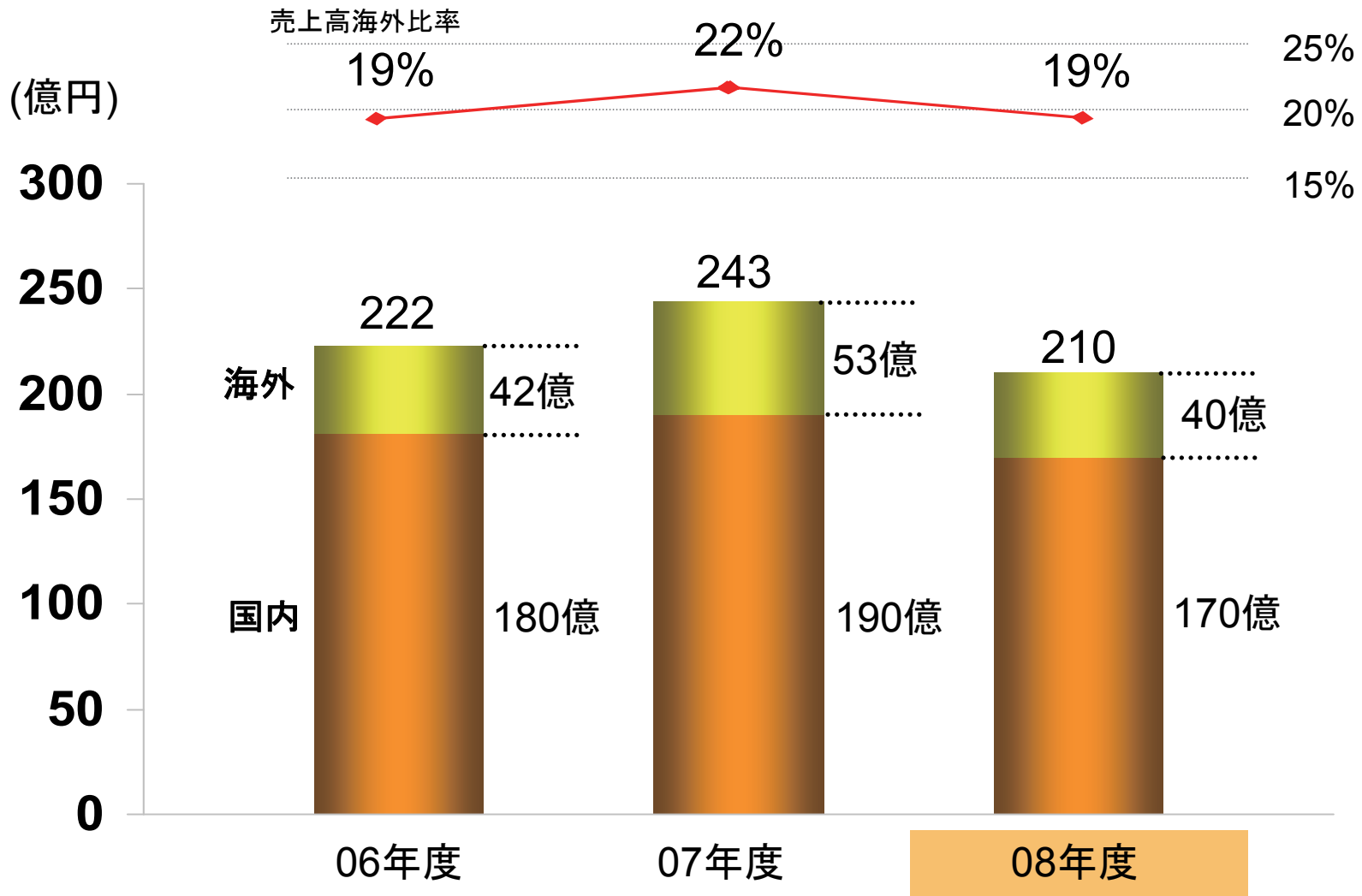


計測事業の受注推移





計測事業の地域別売上高



08年度貸借対照表

(単位:億円)

資産	08/3末 実績	09/3末 実績	増減	負債/純資産	08/3末 実績	09/3末 実績	増減
現預金	157	176	19	支払手形・ 買掛金	195	53	△142
受取手形・ 売掛金	323	119	△204	借入金・社債	184	146	△38
在庫	277	180	△97	その他	66	50	△16
その他	19	23	4	流動負債計	445	249	△197
流動資産計	776	498	△278	固定負債計	76	161	85
固定資産計	301	320	19	負債計	522	410	△112
資産合計	1,077	818	△259	純資産	555	408	△147
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,077 (219)	818 (261)	△259 (42)

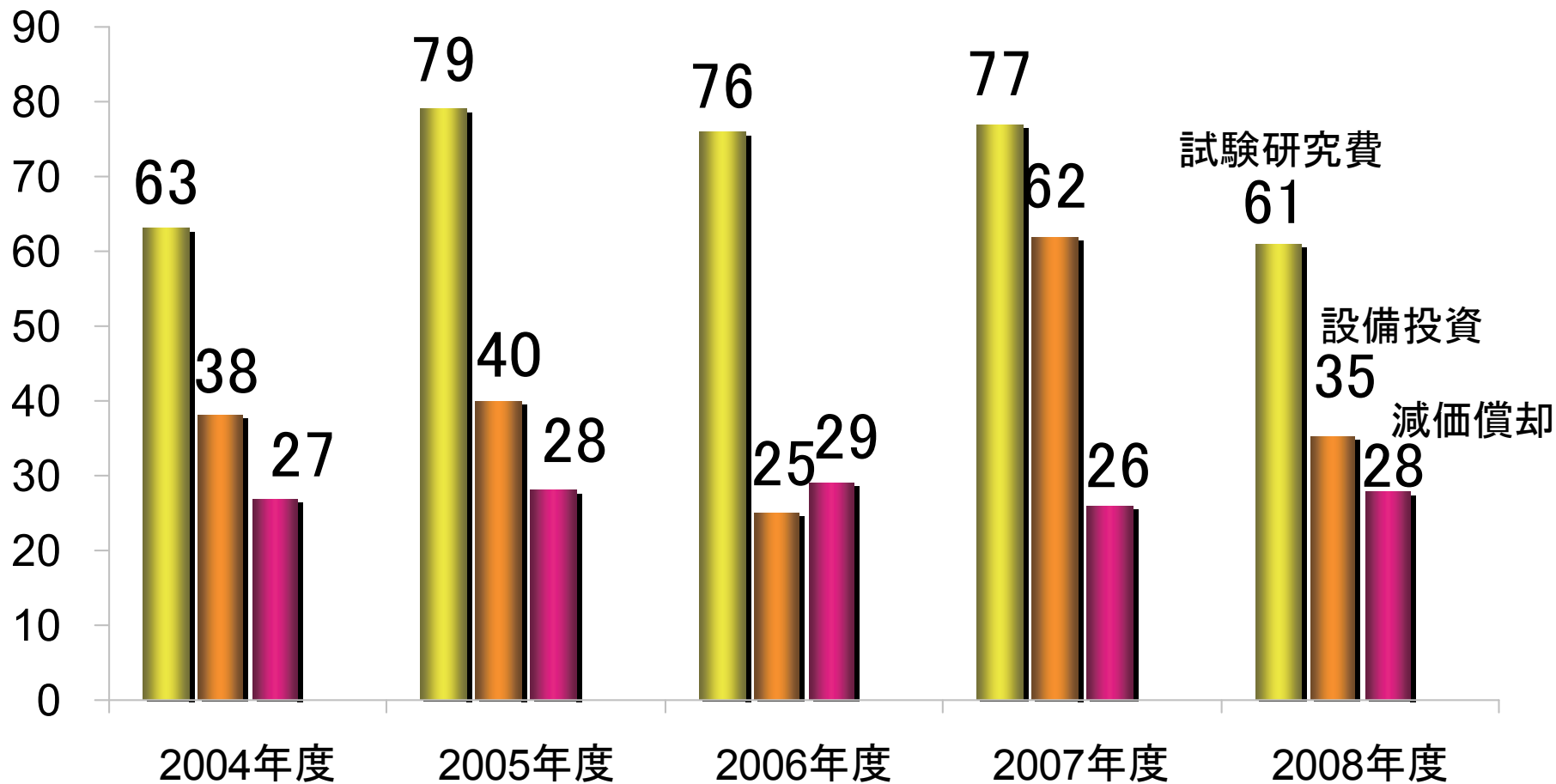
08年度キャッシュフロー

(単位:億円)		06年度	07年度	08年度
現金等 期首残高		138	168	157
営業活動	税引前・償却前利益	161	119	Δ110
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	Δ49	31	148
	納税	Δ22	Δ47	Δ26
	その他	20	Δ3	17
小計		110	100	29
投資活動		Δ34	Δ65	Δ33
フリーキャッシュフロー		76	35	Δ4
財務活動	社債・借入	Δ28	Δ26	42
	配当金等	Δ18	Δ22	Δ16
	小計	Δ46	Δ48	26
増減額		30	Δ11	19
現金等 期末残高		168	157	176



試験研究費、設備投資、減価償却

(億円)





(株)東京精密 2009年3月期(08年度) 決算説明会

次第

- 16:30 開会
- 16:30 – 16:45 2008年度業績説明
代表取締役CFO 太田 邦正
- 16:45 – 17:00 市場環境・2009年度業績予想
当社の戦略**
代表取締役社長 藤森 一雄

◆ 半導体製造装置事業

- 2009年度は前年比マイナス必至
- 受注・売上とも2008年度4Qを底に緩やかな回復基調に
(2009年度下期には前年比プラスに転ずる可能性)

◆ 計測機器事業

- 自動車・工作機械等の低迷で2009年度は厳しい市況が継続
- 2010年度以降緩やかな回復を見込む



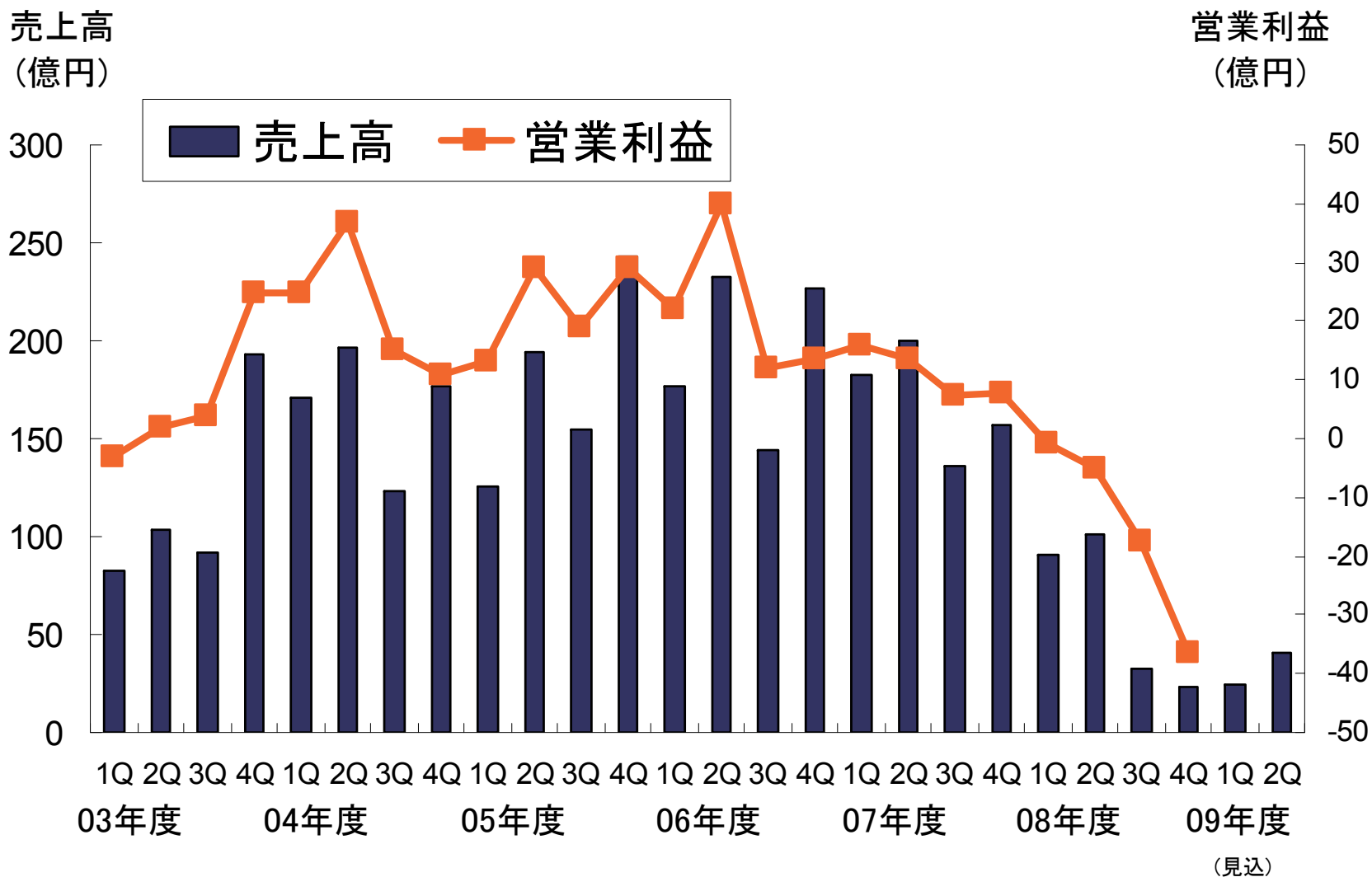
- 市場動向が不透明な中での予想
- 固定費削減による赤字幅圧縮

09年度業績見通し

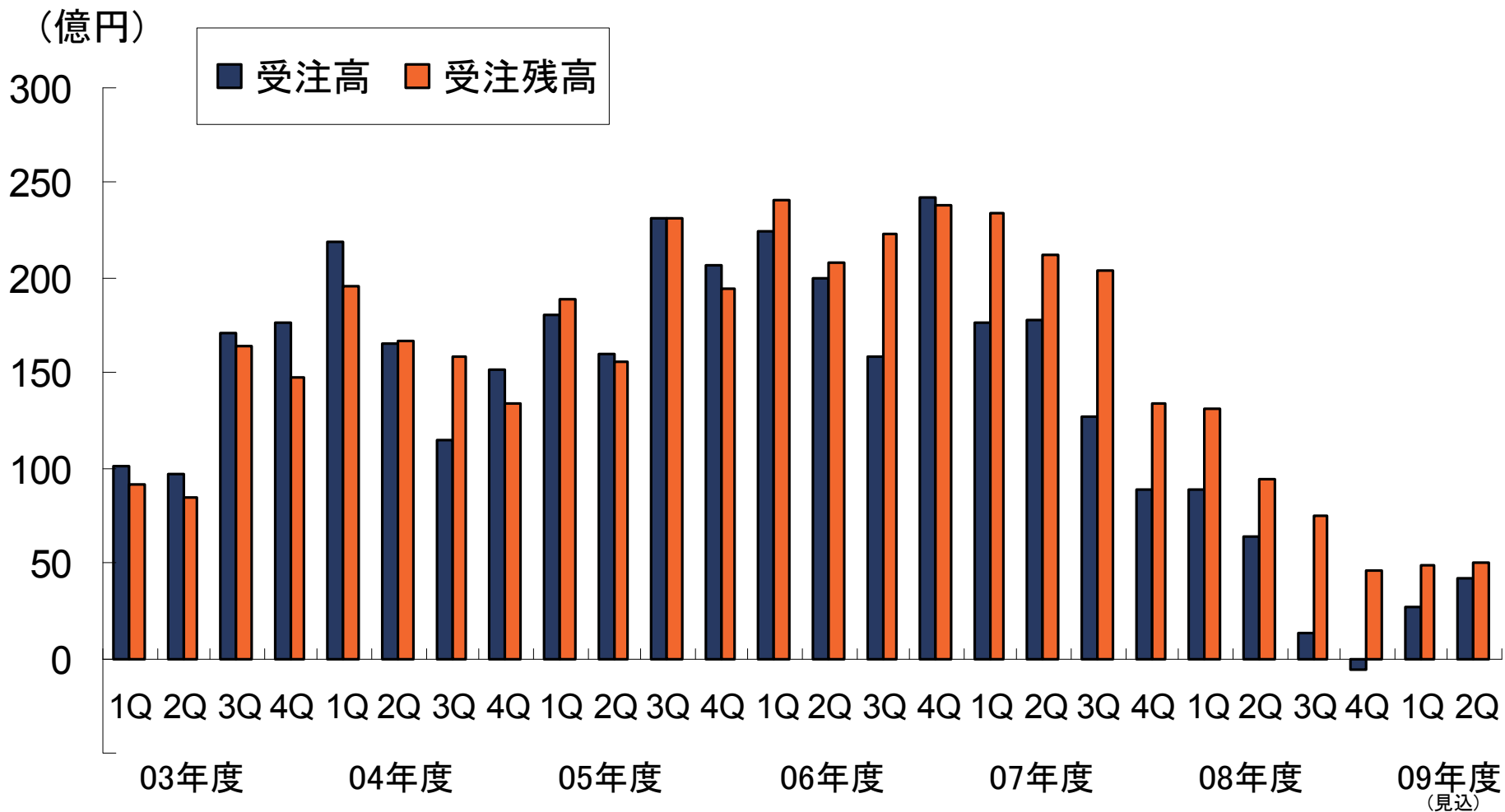
単位: 億円

	07年度		08年度		09年度(予想)			
	上期	下期	上期	下期	上期	前年比	下期	前年比
売上高	499	419	318	139	110	△65%	150	8%
半導体	382	293	192	55	65	△66%	95	73%
計測	117	126	126	84	45	△64%	55	△35%
営業利益	59	45	21	△46	△15	-	△4	-
同率	11.8%	10.8%	6.7%	-	-	-	-	-
経常利益	60	34	26	△54	△18	-	△5	-
当期利益	33	15	△2	△110	△18	-	△5	-
1株配当	30円	40円	15円	0円	0円	△15円	未定	-

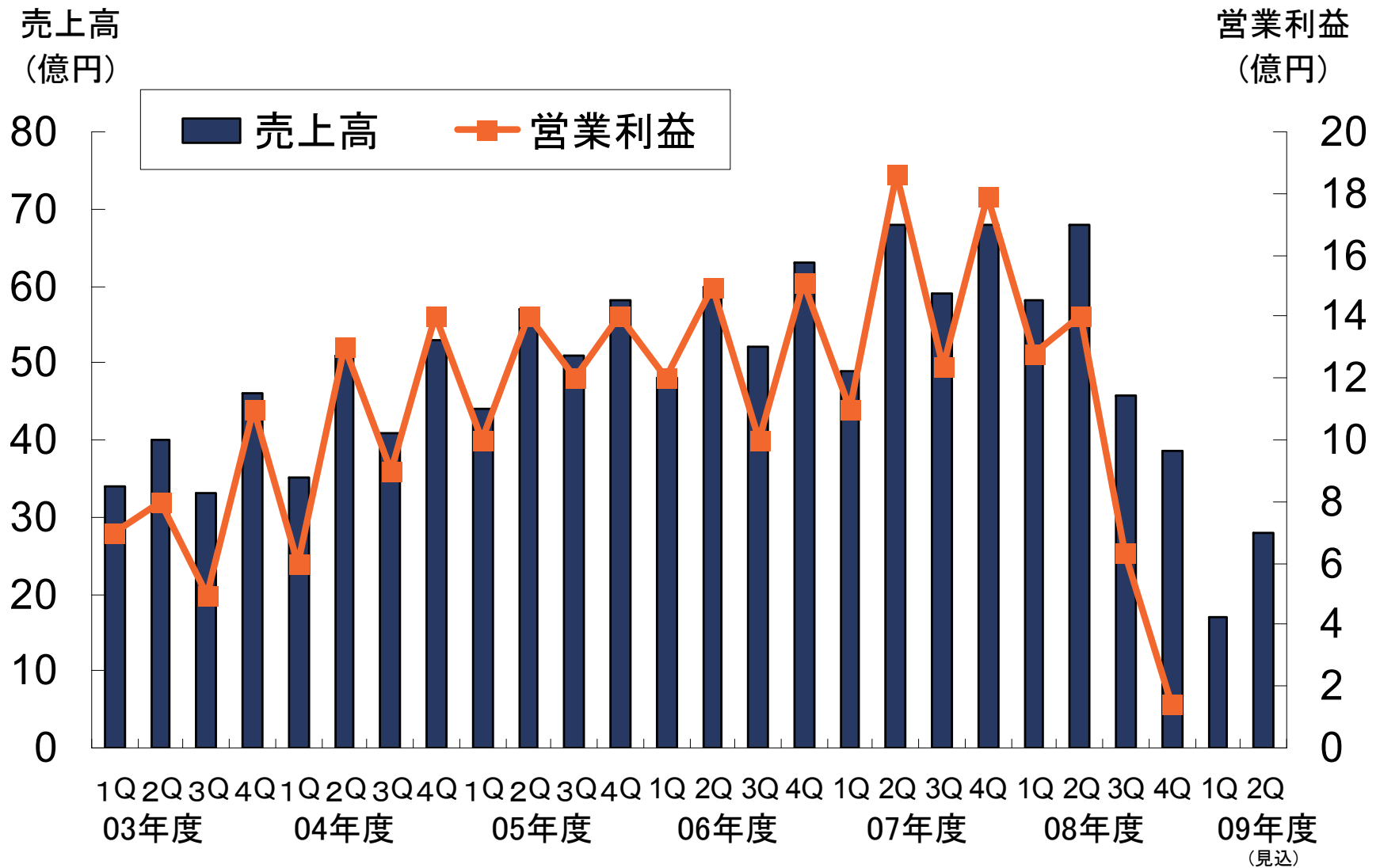
半導体事業の業績推移(見込)



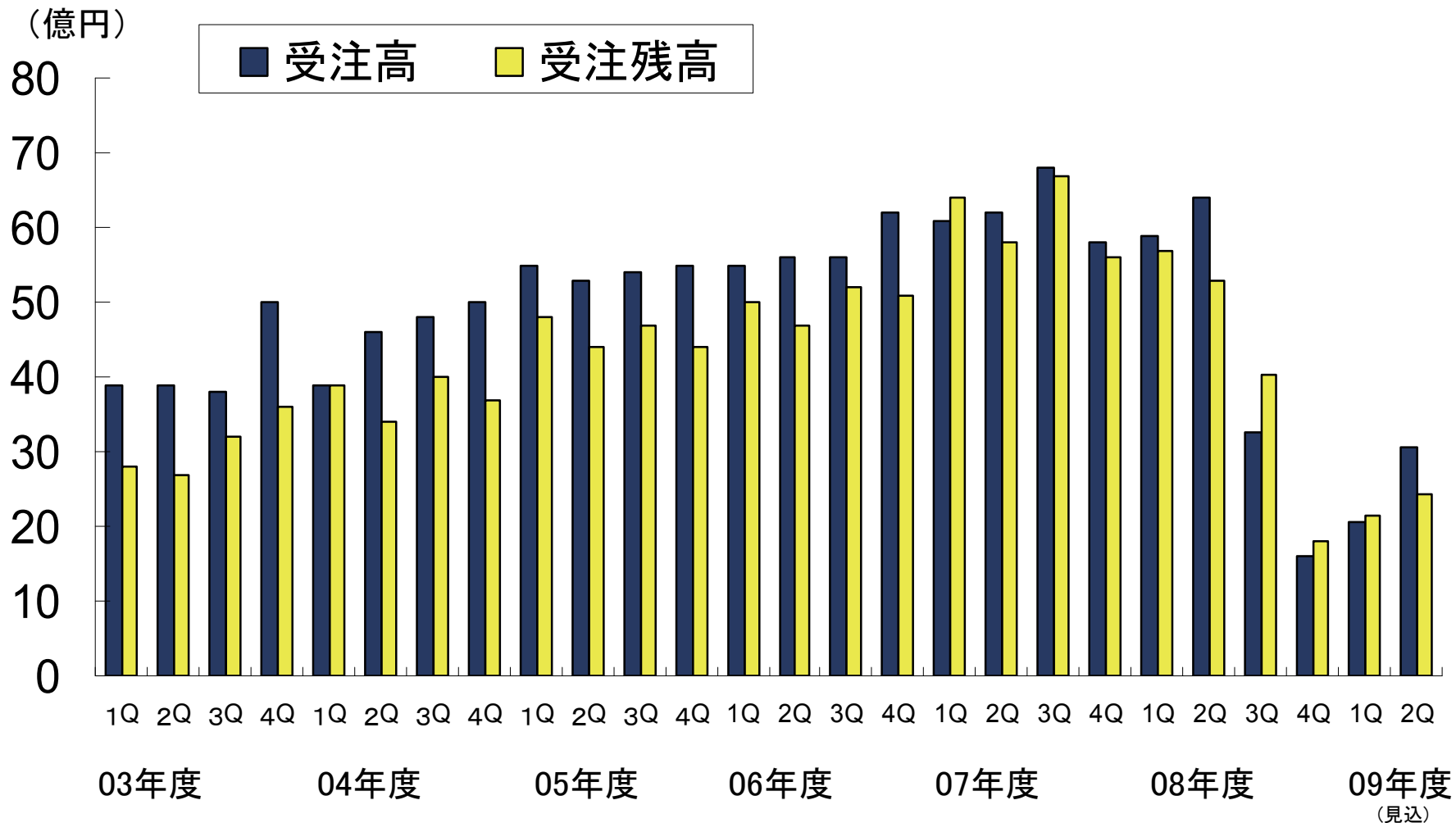
半導体事業の受注推移(見込)



計測事業の業績推移(見込)



計測事業の受注推移(見込)



09年度予想の概要①

◆スリム化への取り組み：固定費削減(4割減)

➤ 人件費削減

● 人員削減

(単位：人)

	08/3末	09/3末	09/4末
従業員数 (正社員＋臨時従業員)	2,198	1,495	1,170

・希望退職、臨時従業員圧縮、定年退職 等

● 報酬・給与減額(役員・管理職・一般社員)

● 一時帰休継続

➤ その他経費削減

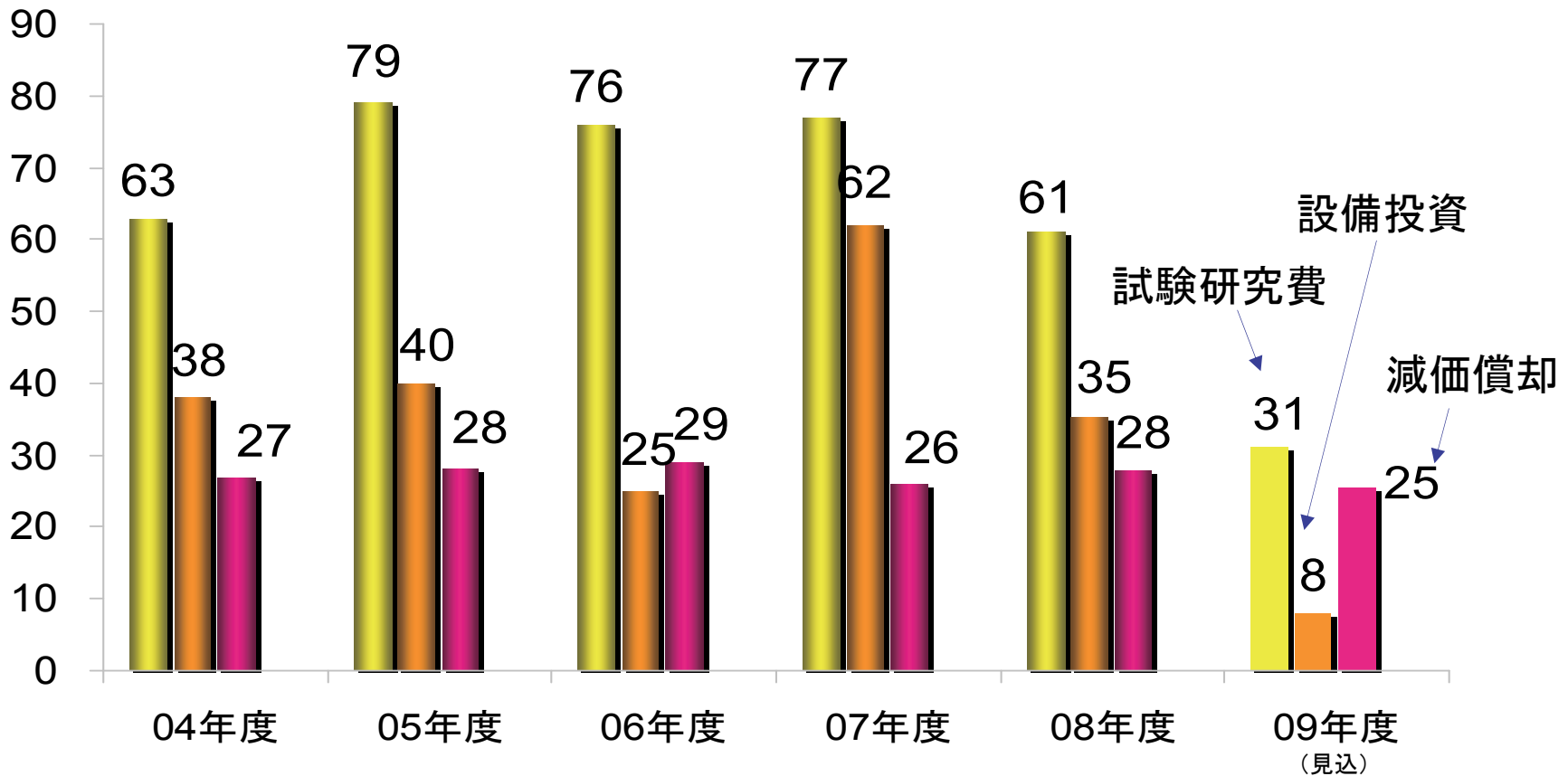
● 販促・広告費削減、旅費・交通費削減、印刷・コピー費削減・・・

09年度予想の概要②

◆スリム化への取り組み

▶試験研究費・設備投資への対応と減価償却見込

(億円)



回復期に向けた体制整備

➤ 海外営業体制の再構築

- アカウント管理体制導入による内外連携緊密化
- 中国営業体制強化
 - ▶ 現地での代理店組織化(計測代理店会発足)、中国拠点網拡充、人員増強

➤ 開発体制の再構築

- 技術部門のワンフロア集約化による円滑な運営・管理
- 半導体 / 計測間の交流人事の促進

➤ 製造体制の再構築

- 多能工化推進による混流生産体制の確立

➤ サービス(受託加工、改造等)売上増強

- 営業 / サービス / 技術部門間の連携緊密化
- オプションのパッケージ化による提案営業



ACCRETECH



東京精密は
アクレーテックです